



△6	△4	178306-5
△6	△3	178306-3
△6	△2	178306-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1 (非累積公差) (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE) (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.					Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan				
WIRE RANGE					INSULATION DIA				
MATERIAL					FINISH				
NAME					12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100				
REVISION RECORD					GENERAL TOLERANCE				
DR. 23 JUN 95 N. Matsubara					10% ±0.3				
CHK. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA					10% ±0.4				
APP. 3 JUL 95 S. MANABE					30% ±0.45				
SCALE 2-1					REV. B1 SHEET 1 OF 1				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[178306-3](#)